

SHENZHEN XIEJIA ELECTRONICS CO.,LTD.		文件编号	XJ-SP-2616
深圳市协佳电子有限公司		发布日期	2003年6月10日
SPECIFICATION 规格书		第A版	第1页 共3页
MODEL NO. 产品名称 .                    ST-303                    ST-304			
DRAWN 制订		APPD. 审批	
1. Temperature range : 1.1 Temperature range for use -25°C ~ 100°C		1. 溫度範圍: 1.1 使用的溫度範圍 -25°C ~ 100°C	
2. Standard atmospheric conditions: Ambient temperature 10°C to 35°C Relative humidity 45 % to 85 % Air pressure 86 KPa to 106 KPa		2. 標準大氣環境: 環境溫度 10°C~35°C 相對濕度 45% ~ 85% 空氣壓力 86 千帕 ~ 106 千帕	
3. Appearance, Structure and Dimension: 3.1 Appearance: Functionally free from rust, crack and bad plating.		3. 外觀、結構和尺寸: 3.1 外觀: 沒有生鏽, 裂痕及電鍍不良影響功能。	
3.2 Structure and Dimension: Reference per attached outline drawing.		3.2 結構和尺寸: 參照有關外形圖。	
4. Rating: <u>DC 16 V 0.3 A</u>		4. 額定值: <u>DC 16 V 0.3 A</u>	
5. Electrical performance.		5. 電氣性能:	
Item 項目	Test conditions 試驗條件	Requirements 規格	
5.1 CONTACT RESISTANCE 接觸電阻	1000Hz Frequency Measured at small current(10 mA or less) 1000Hz 周波在微小電流(10mA)以下測試	接觸插頭	
	Initial Condition 初始條件	50mΩ Max. 50 毫歐以下	
	After Humidity Test 潮濕試驗后 After Heat Test 耐熱試驗后 After Cold Test 耐寒試驗后 After Resistance To Soldering Heat Test 耐焊性試驗后 After Durability Test 耐久性試驗后	100mΩ Max 100 毫歐以下	
	Note: The mate pulg used to this measurement shall be allowed to Clean and remove oxidation film on the surface before test. 注:此測量中所用之匹配插頭,在試驗前應進行清潔且表面無氧化層		
	The insulation resistance between mutual insulated contacts should Be complied with following specification under 500Volts DC 相互絕緣接觸片之間的絕緣電阻應在 DC 500V 條件下符合下列規格		
	Initial Condition 初始條件		
5.2 INSULATION RESISTANCE 絕緣電阻	After Life 壽命試驗后 After Heat Test 耐熱試驗后 After Cold Test 耐寒試驗后 After Resistance To Soldering Heat Test 耐焊性試驗后 After Humidity Test 潮濕試驗后	100MΩ Min. 100 兆歐以上	
	50MΩ Min. 50 兆歐以上		
	Note: The mate pulg used to this measurement shall be allowed to Clean and remove oxidation film on the surface before test. 注:此測量中所用之匹配插頭,在試驗前應進行清潔且在表面無氧化層		
	Aply AC 500V (50~60Hz) between any adjacent open terminals for 1 minute. 在相鄰開路端子之間施加 AC 500v(50~60Hz)負載持續 1 分鐘。		
	Shall be free from breakage. 無擊穿現象出現。		

SHENZHEN XIEJIA ELECTRONICS CO.,LTD. 深圳市协佳电子有限公司		文件编号 发布日期	XJ-SP-2616 2003年6月10日
SPECIFICATION 规格书		第A版	第2页 共3页
6.Mechanical Performance 机械性能			
Item 项目	Test conditions 试验条件		Requirements 规格
6.1	INSERTION FORCE 插入力度	Initial Condition 初始条件	0.4Kgf ~ 3.0Kgf
		After Life 寿命试验后	0.3Kgf ~ 3.0Kgf
		After Humidity Test 潮湿试验后	
		After Heat Test 耐热试验后	
		After Cold Test 耐寒试验后	
		After Resistance To Soldering Heat Test 耐焊性试验后	
WITHDRAWAL FORCE 拔出力度	Initial Condition 初始条件	0.4Kgf ~ 3.0Kgf	
	After Life 寿命试验后	0.2Kgf ~ 3.0Kgf	
	After Humidity Test 潮湿试验后		
	After Heat Test 耐热试验后		
	After Cold Test 耐寒试验后		
	After Resistance To Soldering Heat Test 耐焊性试验后		
6.2	TERMINAL STRENGTH 端子强度	A static force of 500gf being applied in one direction on the top of the terminal for 1 minute. 将一个 500 克的静负荷施加在端子的任意一个方向上 1 分。	There shall be no damage to the terminal such as cracks looseness or play. electrical and mechanical characteristics shall be satisfied. 端子无断裂、松动等异常并要满足机械、电气性能
7. Durability 耐久性			
Item 项目	Test conditions 试验条件		Requirements 规格
7.1	LIFE TEST 寿命试验	The durability test shall consist of 5000 mating cycles of insertion and Extraction with the mated plug or the gauge plug at rate 10~20cycles Per minute, no load condition, with or without lubricant which should Be specified the detail requirement. 包括在无载条件下用匹配插头或测量插头以每分钟 10~20 回的速度插入、拔出 5,000 回。是否用润滑剂, 应规定具体的要求。	The relative test before and after this test should complied with paragraph 5.1 and 6.1 在此项试验前后,插座的性能应符合 5.1 和 6.1 中的规定。
7.2	HUMIDITY TEST 潮湿试验	40 ±2°C, 90-95% RH for 96 hours after test kept in normal condition for 30 minutes. 在 40±2°C, 90-95%的相对湿度环境中放 96 小时,再放在正常环境中 30 分钟后进行测试。	Without harmful damage in appearance, paragraph 5 and 6.1 shall be satisfied. 外表未被破坏, 电气性能及操作力可被满足。
7.3	HEAT TEST 耐热试验	70 ±2°C, 50% RH for 96 hours after test kept in normal condition for 30 minutes. 在 70±2°C, 小于 50%的相对湿度环境中放 96 小时,再放在正常环境中 30 分钟后进行测试。	

SHENZHEN XIEJIA ELECTRONICS CO.,LTD. 深圳市协佳电子有限公司		文件编号 发布日期	XJ-SP-2616 2003年6月10日
SPECIFICATION 规格书		第A版	第3页共3页
Item 项目	Test conditions 试验条件		Requirements 规格
7.4	COLD TEST 耐冷試驗	-40 ±2°C, 50% RH for 96 hours after test kept in normal condition for 30 minutes. 在-40±2°C, 小于50%的相對濕度環境中放96小時, 再放在正常環境中30分鐘后進行測試。	Without harmful damage in appearance, paragraph 5 and 6.1 shall be satisfied. 外表未被破壞, 電氣性能及操作力可被滿足。
7.5	SOLDERABILITY TEST 可焊性試驗	The terminals shall be dipped in the solder bath of 240±5°C for 3±0.5 seconds. 端子被浸入錫焊池中, 溫度為240±5°C, 時間為3±0.5秒。	The area of soldering should be over 75% 焊接覆蓋面積要有75%以上
7.6	RESISTANCE TO SOLDERING HEAT TEST 耐焊性試驗	The top of the terminals shall be dipped 2mm in the solder of 260 ±10°C, for 3±0.5 seconds. 端子頂部被浸入錫焊池中2mm深, 溫度為260 ±10°C, 時間為5±1秒。	Without harmful damage in appearance, paragraph 5 and 6.1 shall be satisfied. 外表未被破壞, 電氣性能及操作力可被滿足。
8.Reflow soldering hear test 軟熔焊接熱試驗			
8.1 Test condition 試驗條件:			
Temps(°C)/溫度			h = hour/小時 m = min/分 s = sec/秒
*Temperature means The temperature of the PC board surface *溫度指PC板表面的溫度			Time(sec)/時間(秒)
8.2 The terminal for a lead wire: 導線端子.			
Solder time/焊接時間: 3±0.5 秒.			
Solder iron/烙鐵溫度: 350±10°C.			
8.3 Solderability: 可焊性			
Solder time/焊接時間: 3±0.5 秒; Solder Pot/焊池溫度: 240±5°C。			
Flux: rosin methanol / 焊劑: 松香、甲醇			
(The jack shall be covered more than three quarters of immersed area)			
(浸入區域的3/4以上範圍應被覆蓋)			